

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年4月16日(2009.4.16)

【公表番号】特表2008-536296(P2008-536296A)

【公表日】平成20年9月4日(2008.9.4)

【年通号数】公開・登録公報2008-035

【出願番号】特願2008-500764(P2008-500764)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 21/3213 (2006.01)

H 01 L 21/306 (2006.01)

C 23 F 1/00 (2006.01)

C 23 F 4/00 (2006.01)

C 23 C 8/36 (2006.01)

C 23 C 8/10 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/302 104 C

H 01 L 21/88 C

H 01 L 21/306 F

C 23 F 1/00 101

C 23 F 4/00 A

C 23 C 8/36

C 23 C 8/10

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月10日(2009.2.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項20】

銅層をエッチングする方法であって、

プラズマ室内で摂氏約200度を越える温度で第1のプラズマによって前記銅層の少なくとも一部を酸化し、

前記銅層の前記酸化部分を実質的に除去し、約10nm未満の平均表面粗さを有する残存表面を露出させるために、前記プラズマ室内で摂氏約100度未満の温度で第2のプラズマによって前記銅層をエッチングする、こと、

を備える方法。